*L'USINE DU FUTUR

UN NOUVEAU MODÈLE D'INTELLIGENCE OPÉRATIONNELLE





POUR PRENDRE CONTACT AVEC MAPP

Manuel FENDLER

Responsable Plateforme MAPP

06 30 24 48 10

manuel.fendler@cea.fr

Anne FRITSCH-RENARD

Responsable Partenariats

06 85 42 24 85

anne.fritsch-renard@cea.fr







CEA Tech GRAND EST

Metz Technopole, 5 Rue Marconi - 57070 Metz - France









METTEZ VOTRE USINE SOUS CONTRÔLE GRÂCE AUX TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES



*CONNECTIVITÉ

DES MACHINES ET DES OUTILS CONNECTÉS POUR PLUS D'AGILITÉ



Capteurs & IoT Capteurs & IoT Capteurs & IoT Capteurs & IoT Automates existants Automates existants COMMUNICATION EXECUTION VISUALISATION Bureau d'Études Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Production Logistique Expéditions Marketing & ventes SAV

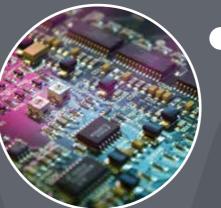
INTELLIGENCE

DES MACHINES ET DES OUTILS POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

+ DE PERFORMANCE

OUTIL INSTRUMENTÉ

- La mesure au plus prés de la production.
- La boucle de rétroaction intégrée communicante.



+ DE VALEUR AJOUTÉE

PIÈCE INSTRUMENTÉE

- Une augmentation du potentiel d'usage.
- Une prestation de service qui pérennise le client.



+ DE CONTRÔLE

OUTILLAGE INSTRUMENTÉ

- Un procédé monitoré et maintenu.
- Un système expert communicant avec l'OS industriel.



+

NOTRE EXPERTISE

MULTI-PHYSIQUE ET MULTI-ÉCHELLE





CO-CONCEPTION MÉCATRONIQUE



- CAO Electronique
- Fabrication Additive et Soustractive
- Micro-usinage mécanique
 et laser
- Gravure circuits multicouches
- Substrats rigides et flexibles
- Intégration électronique / report de puces
- Packaging et assemblage
- Programmation Micro contrôleur & FPGA
- Acquisition et fusion de données
- Logiciel embarqué
- Interface homme-machine



ROBUSTESSE EN ENVIRONNEMENT SÉVÈRE



- Modélisation mécanique
- Simulation thermique
- Simulation thermomécanique
- Tests environnementaux (T°C / % RH / Vibration)
- Essais mécaniques micro/ macro
- Banc de fatigue multiaxiale
- Tests électriques analogiques/numériques
- Caractérisation électronique
- CEM et télécommunications
- Analyse de défaillance
- Décapsulation électronique
- · Reverse engineering
- Observations microstructurales
- Contrôles infrarouge/ acoustique/RX



TRAITEMENT DE L'INFORMATION

- Knowledge Mapping
- Capitalisation de Connaissances / Interne & Externe / Tacite & Explicite
- Qualification TRIZ des besoins
- Ingénierie Système
- Data Mining
- Machine Learning



